

第24回 有機/無機接合研究委員会

日時：2025年3月13日（木）13:30～16:30

場所：拓殖大学 文京キャンパス（オンライン併用開催）

プログラム

司会 井上 雅博（群馬大学）

13:30～13:40 委員会議事

13:40～14:20

『半導体後工程向け低誘電・高柔軟・感光性ポリイミド組成物の開発』（40分）

..... ○山口 貴史（荒川化学工業(株)）

14:20～15:00

『量産実績を持つ OKI 独自の異種材料接合技術 CFB とその未来への展望』（40分）

..... ○鈴木 貴人（沖電気工業(株)）

15:00～15:10 休憩

司会 木村 文信（東京大学）

15:10～15:50

『炭素繊維強化プラスチックとアルミニウム合金の

熱圧接合強度に及ぼす諸条件の定量化評価』（40分）

.....○李蔚豪, 耿 培皓, 麻寧緒（大阪大学）

15:50～16:30

『大気圧低温プラズマを用いた異種材料間の接着性向上』（40分）

..... ○山崎 顕一（東芝インフラシステムズ(株)）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会